

证券代码:688307 证券简称:优迅股份 公告编号:2026-003

厦门优迅芯片股份有限公司 关于增加募集资金投资项目 实施主体及实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

· 厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称“公司”或“优迅股份”）计划新增全资子公司武汉芯智光联科技有限公司（以下简称“武汉芯智光联”）作为公司募集资金投资项目“下一代接入网及高速数据中心电芯片开发及产业化项目”的实施主体，该募投项目的实施地点相应由厦门市变更为武汉市、武汉市；新增公司，全资子公司上海优迅芯创科技股份有限公司（以下简称“上海优迅芯创”）作为武汉芯智光联募集资金投资项目“车载电芯片研发及产业化项目”的实施主体，该募投项目的实施地点相应由武汉市变更为武汉市、厦门市；新增公司，全资子公司优迅芯创科技股份有限公司（以下简称“上海优迅芯创”）作为武汉芯智光联募集资金投资项目“800G及以上光通信电芯片与硅光组件研发项目”的实施主体，该募投项目的实施地点相应由武汉市变更为武汉市、厦门市、上海市。

· 公司于2026年1月23日召开了公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“中信证券”）发表了明确的同意意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2397号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）2,000万股，发行价格51.66元/股，募集资金总额为人民币103,320.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币92,768.83万元。以上募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12月12日出具的《厦门优迅芯片股份有限公司验资报告》（容验字[2025]36120063号）审验确认。

公司（含子公司）已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

二、募集资金投资项目基本情况

《厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位:万元				
序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额	占比投资比例
1	下一代接入网及高速数据中心电芯片开发及产业化项目	46,780.65	46,780.65	100.00%
2	车载电芯片研发及产业化项目	16,908.47	16,908.47	100.00%
3	800G及以上光通信电芯片与硅光组件研发项目	17,217.38	17,217.38	100.00%
合计		80,906.50	80,906.50	100.00%

公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投资额的部分为超募资金，超募资金为11,862.34万元（以上数据如有尾数差异，为四舍五入所致）。

三、本次募集资金投资项目新增实施主体及实施地点的情况

为优化资源配置、提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及规章制度的规定，公司新增全资子公司武汉芯智光联作为“下一代接入网及高速数据中心电芯片开发及产业化项目”实施主体，新增公司及全资子公司上海优迅芯创作为“800G及以上光通信电芯片与硅光组件研发项目”的实施主体。公司将分别与上述子公司共同实施上述募投项目。

(一)新增募投项目实施主体的基本情况

1、武汉芯智光联作为公司的全资子公司，其基本情况如下：

公司名称	武汉芯智光联科技有限公司
统一社会信用代码	91420100MADPNAB660
法定代表人	柯鹏隆
注册资本	1,000万元
成立日期	2024年3月29日
住所	湖北省武汉市东湖新技术开发区关山一路一号华中高光软件园内隆大殿A栋301室（自贸试验片区）
经营范围	集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流服务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，依法自主开展经营活动）

2、上海优迅芯创作为公司的全资子公司，其基本情况如下：

公司名称	上海优迅芯创科技股份有限公司
统一社会信用代码	91310000MAE1BMN9XX
法定代表人	柯鹏隆
注册资本	3,000万元
成立日期	2025年4月24日
住所	上海市浦东新区草桥路1号创新魔方一期4号楼601
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售。（除依法须经批准的项目外，依法自主开展经营活动）

(二)募投项目实施主体及实施地点的调整情况

经调整后，公司募投项目的实施主体及实施地点情况如下：

项目名称	新增前		新增后		
	拟投入募集资金金额(万元)	实施主体	实施地点	实施主体	实施地点
下一代接入网及高速数据中心电芯片开发及产业化项目	46,780.65	优迅股份	厦门市、武汉市	优迅股份、武汉芯智光联	厦门市、武汉市
车载电芯片研发及产业化项目	16,908.47	武汉芯智光联	武汉市、厦门市	优迅股份、武汉芯智光联	武汉市、上海市
800G及以上光通信电芯片与硅光组件研发项目	17,217.38	武汉芯智光联	武汉市、厦门市	优迅股份、武汉芯智光联	武汉市、上海市
合计					

公司及子公司可根据募投项目建设安排及资金需求，在《厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》约定的拟投入募集资金范围内，一次或分次逐步向实施主体提供借款，借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，根据项目实施情况可提前还款或到期续借，借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施，不得用作其他用途。

除新增募集资金投资项目实施主体及实施地点外，原募集资金投资项目因公司的实际需求推进，根据项目实施情况可提前还款或到期续借，借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施，不得用作其他用途。

增加募集资金投资项目实施主体及实施地点对公司的影响

本次现金管理使用最高额不超过人民币70,000万元（含本数），使用期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

(四)投资方式

1、投资产品品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金购买协定存款、七天通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单及收益凭证等安全性高、流动性好的保本型产品，同时可按募投项目资金需求随时赎回或支取，提前赎回或支取仅损失一定收益。

2、投资额度及期限

本次现金管理使用最高额不超过人民币70,000万元（含本数），使用期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

(五)实施方式

董事会授权公司总经理在上述额度范围及有效期内行该项投资决策权并签署相关合同等文件，包括但不限于选择产品品种、签署合同、开立或注销产品专用结算账户等，同时授权公司及相关子公司的财务部门具体实施相关事宜。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，公司将严格按照中国证监会监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求使用和管理资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

3、审议程序

公司于2026年1月23日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。该事项无需提交股东大会审议。

4、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资协定存款、七天通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单及收益凭证等安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该投资项目受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、实时分析和跟踪产品的变动情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

3、独立董事、董事会会审议委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格依据相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

5、公司将依据中国证监会监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

6、保荐人对公司的影响

本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位:万元

序号	项目名称	单位:万元	
		项目总投资	拟投入募集资金金额
1	下一代接入网及高速数据中心电芯片开发及产业化项目	46,780.65	46,780.65
2	车载电芯片研发及产业化项目	16,908.47	16,908.47
3	800G及以上光通信电芯片与硅光组件研发项目	17,217.38	17,217.38
合计		80,906.50	80,906.50

(一)下一代接入网及高速数据中心电芯片开发及产业化项目

1、项目投资概算

本项目预计投资总额46,780.65万元，项目投资概算及资金使用计划如下：

单位:万元

序号	投资内容	单位:万元	
		总投资额	拟投入募集资金金额
1	建设投资(除设备)	9,011.31	9,011.31
2	设备购置费用	6,826.84	6,826.84
3	IT及软件费用	3,670.00	3,670.00
4	测试费用	9,834.50	9,834.50
5	人工费用	1,420.00	1,420.00
6	其他费用	16,018.00	16,018.00
合计		46,780.65	46,780.65

二、项目周期和时间进度

序号	T1	T2	T3	T4	T5	T6
1	建设投资(除设备)					
2	设备购置费用					
3	IT及软件费用					
4	测试费用					
5	人工费用					
6	其他费用					
合计						

(二)车载电芯片研发及产业化项目

1、项目投资概算

本项目预计投资总额16,908.47万元，项目投资概算及资金使用计划如下：

单位:万元

序号	投资内容	总投资额	募集资金投资额	占比投资比例

<tbl_r cells="5